

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成31年4月18日 (2019.4.18)

【公開番号】特開2017-175092(P2017-175092A)
【公開日】平成29年9月28日 (2017.9.28)
【年通号数】公開・登録公報2017-037
【出願番号】特願2016-62869(P2016-62869)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/92 6 0 2 G

H 0 1 L 21/60 3 1 1 S

H 0 1 L 21/92 6 0 2 N

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月5日 (2019.3.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、上記基板の一方の面に形成されたバンプとを備え、
上記バンプは、接続対象部品の電極と接続される接続面の面積が、上記基板側の基部の面積よりも大きい電子部品。

【請求項 2】

上記バンプの断面積は、上記基部から上記接続面にかけて、規則的に増加する請求項 1 に記載の電子部品。

【請求項 3】

上記バンプの側面の辺は直線である請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 4】

上記バンプの側面の辺は非直線である請求項 1 又は 2 に記載の電子部品。

【請求項 5】

複数の上記バンプが配列されたバンプ列が形成されている請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の電子部品。

【請求項 6】

上記バンプ列の各バンプは、同一方向から見た側面形状が同一である請求項 5 に記載の電子部品。

【請求項 7】

上記バンプ列の各バンプは、同一方向から見た側面形状が非同一である請求項 5 に記載の電子部品。

【請求項 8】

上記接続面は、上記基板と略平行である請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の電子部品。

【請求項 9】

請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の電子部品の上記バンプと、上記バンプに対向した電極を備えた第 2 の電子部品が、導電性粒子を備えた異方性導電接着剤によって、異方性接続されている異方性接続構造体。

【請求項 10】

基板と、上記基板の一方の面に形成されたパンプとを備える電子部品の設計方法において、

上記パンプは、接続対象部品の電極と接続される接続面の面積が、上記基板側の基部の面積よりも大きくされている電子部品の設計方法。

【請求項 11】

請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載の電子部品の上記パンプと、上記パンプに対向した電極を備えた第 2 の電子部品とを、導電性粒子を備えた異方性導電接着剤によって、異方性接続する異方性接続構造体の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、本技術に係る電子部品の設計方法は、基板と、上記基板の一方の面に形成されたパンプとを備える電子部品の設計方法において、上記パンプは、接続対象部品の電極と接続される接続面の面積が、上記基板側の基部の面積よりも大きくされているものである。

また、本技術に係る異方性接続構造体の製造方法は、上記記載の電子部品の上記パンプと、上記パンプに対向した電極を備えた第 2 の電子部品とを、導電性粒子を備えた異方性導電接着剤によって、異方性接続するものである。